

## 【改正の概要】

産業構造審議会・安全保障貿易管理小委員会の中間報告（2021年6月10日公表）では、大量破壊兵器関連品目について、半導体製造装置等の部分品等に関する管理の在り方を一定程度合理化すべきことが提言されました。

本提言を受けて、適切な輸出管理を実施しつつ、輸出者等の輸出管理に係る負担軽減を図るため、輸出令別表第1の3の項（2）7又は9に掲げる貨物であって、

1. 特定の半導体メーカー向けの半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるものに限り、「は地域②（ち地域を除く）」又は「に地域②（ち地域を除く）」を仕向地とする輸出について、一定の条件の下、特別一般包括許可を適用可能とする、
  2. 一部の貨物に限り、特定包括許可の継続的な取引関係等に係る要件を緩和する、
- こととなりました。

その後、改正通達（包括許可取扱要領）に係るパブリック・コメントを経て、2021年11月18日に公布・施行されました。

## 【改正経緯を知りたい方へ】

- [産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会中間報告（2021年6月10日）](#)

## 【改正内容をもっと知りたい方へ】

- [包括許可取扱要領（新旧対照表／改正後）](#)
- [改正概要](#)
- [「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」を仕向地とする半導体製造用ポンプ・バルブの申請手続きの新旧対比](#)
- [包括許可制度見直し後の適用範囲比較](#)

## 【改正後の手続きの流れを知りたい方へ】

- [輸出令別表第1の3の項（2）7又は9に掲げる貨物（輸出令別表第1の3の項（2）7又は9に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号、第40号に該当するものを除く。）のうち、「は地域②（ち地域を除く。）」又は「に地域②（ち地域を除く。）」を仕向地として輸出する場合に係る手続きフロー及び各手続きにて可能性のある違反例について](#)

## 【特別一般包括許可を使用する輸出者の方へ】

- [特別一般包括許可に係る届出書（様式第14）](#) ※別紙含む
- [特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可に係る実績報告書（様式第18）](#)
- 上記届出書及び実績報告書の提出先  
＜メールアドレス＞ [bzl-anpo-shinsa-3@meti.go.jp](mailto:bzl-anpo-shinsa-3@meti.go.jp)  
＜宛先＞ 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易審査課3班

## 【改正内容に疑問点や不明点がある方へ】

- [改正に係る Q&A](#)